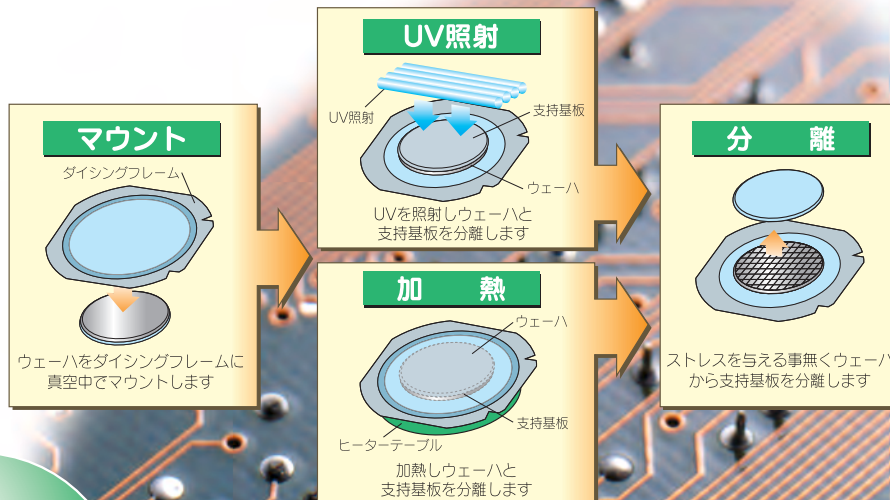


# MODEL GWS-300R

## ウェーハ/支持基板分離装置

### 概要

本装置は、支持基板に貼付けられたウェーハを真空チャンバー内でマウントし、UV照射（又は加熱）後、支持基板の分離を行います。  
超薄厚ウェーハのハンドリング及びマウントはタカトリ独自の吸着エレメント、真空チャンバーの採用によりウェーハにストレスを与えません。



**8・12**インチ  
ウェーハ対応



仕様	WSM-300R
スループット	30~40枚/h
対応ウェーハサイズ	8インチ、12インチ
装置寸法	D2,500 × W2,300 × H1,800mm
重量	1,400(UV200kg含)kg

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。